

2025年3月期
決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2025年5月13日

2025年3月期 決算概要

【連結会計期間】

日本国内(1社)：4月～3月／海外(10社)：1月～12月

● 表面処理用資材事業

- ・ 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品の需要は緩やかな回復基調で推移しました。また、為替相場の円安による効果も寄与し、売上高、セグメント利益ともに前連結会計年度を上回りました。

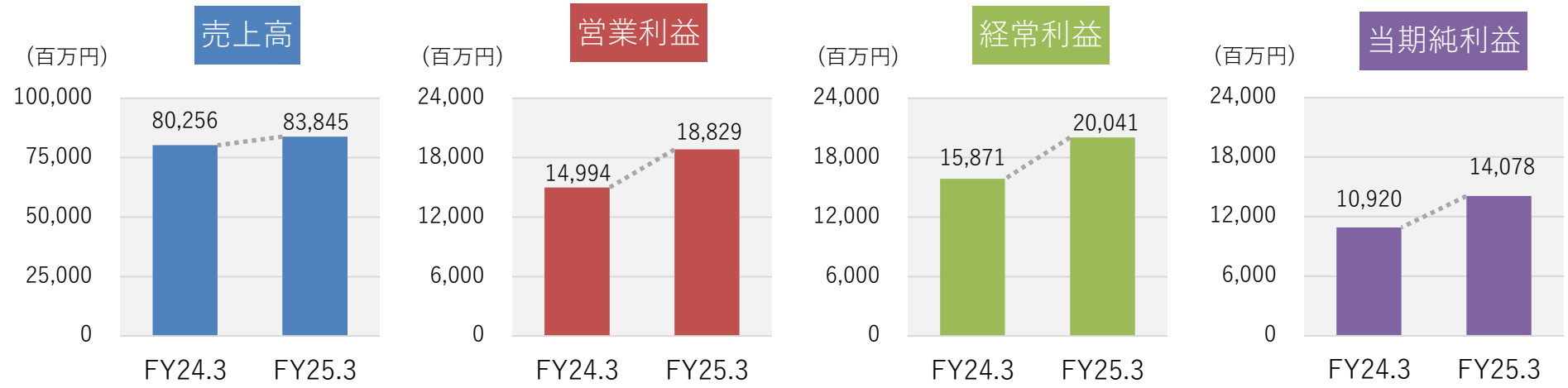
● 表面処理用機械事業

- ・ パッケージ基板メーカーによる設備投資が一巡したことから、売上高、セグメント利益ともに前連結会計年度を下回りました。

● めっき加工事業

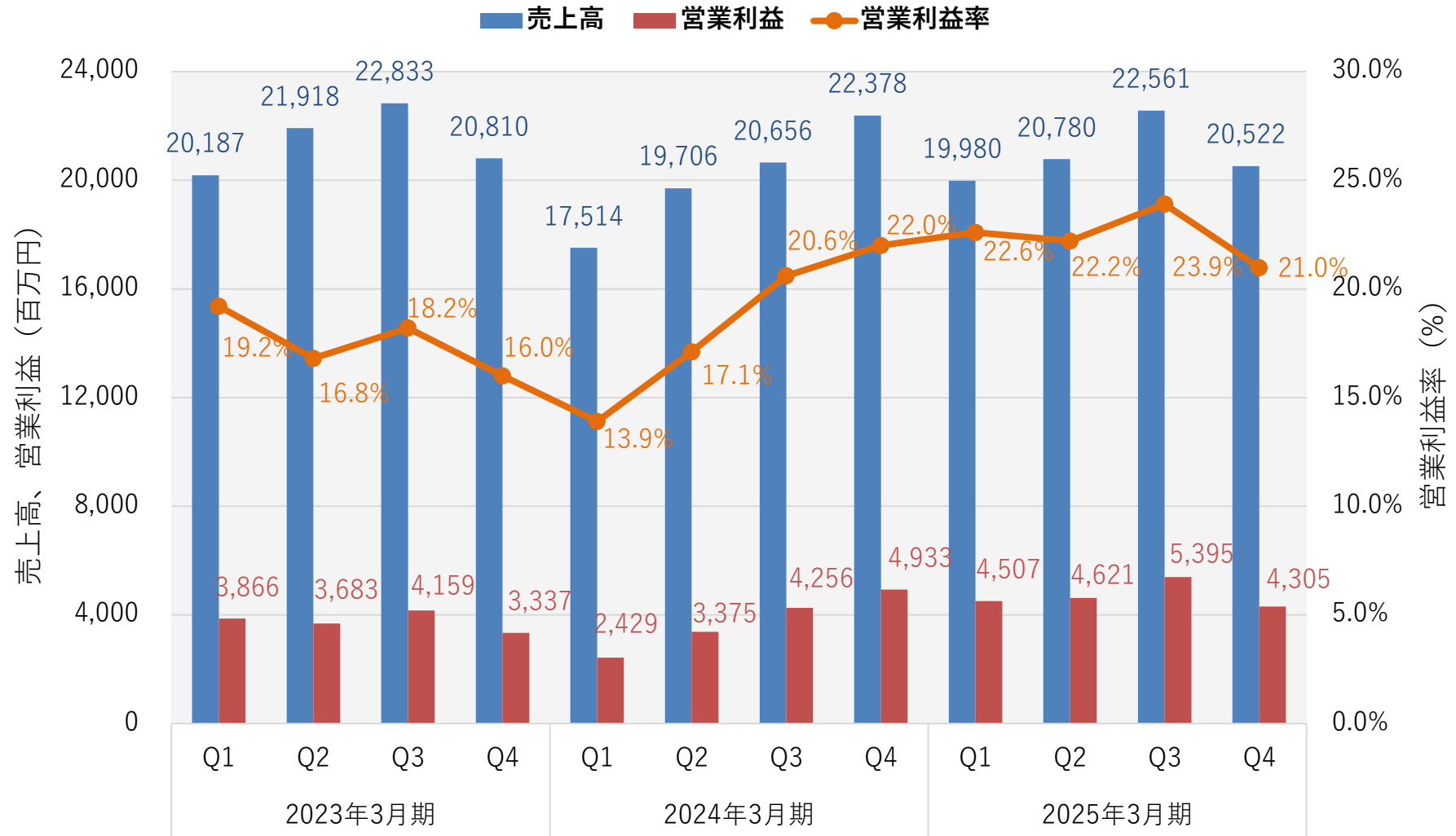
- ・ 自動車部品向けのめっき加工の需要は低調に推移し、売上高は前連結会計年度を下回りましたが、コスト削減や歩留まりの改善に取り組んだことから、セグメント損失は前連結会計年度より改善しました。

2025年3月期 決算概要

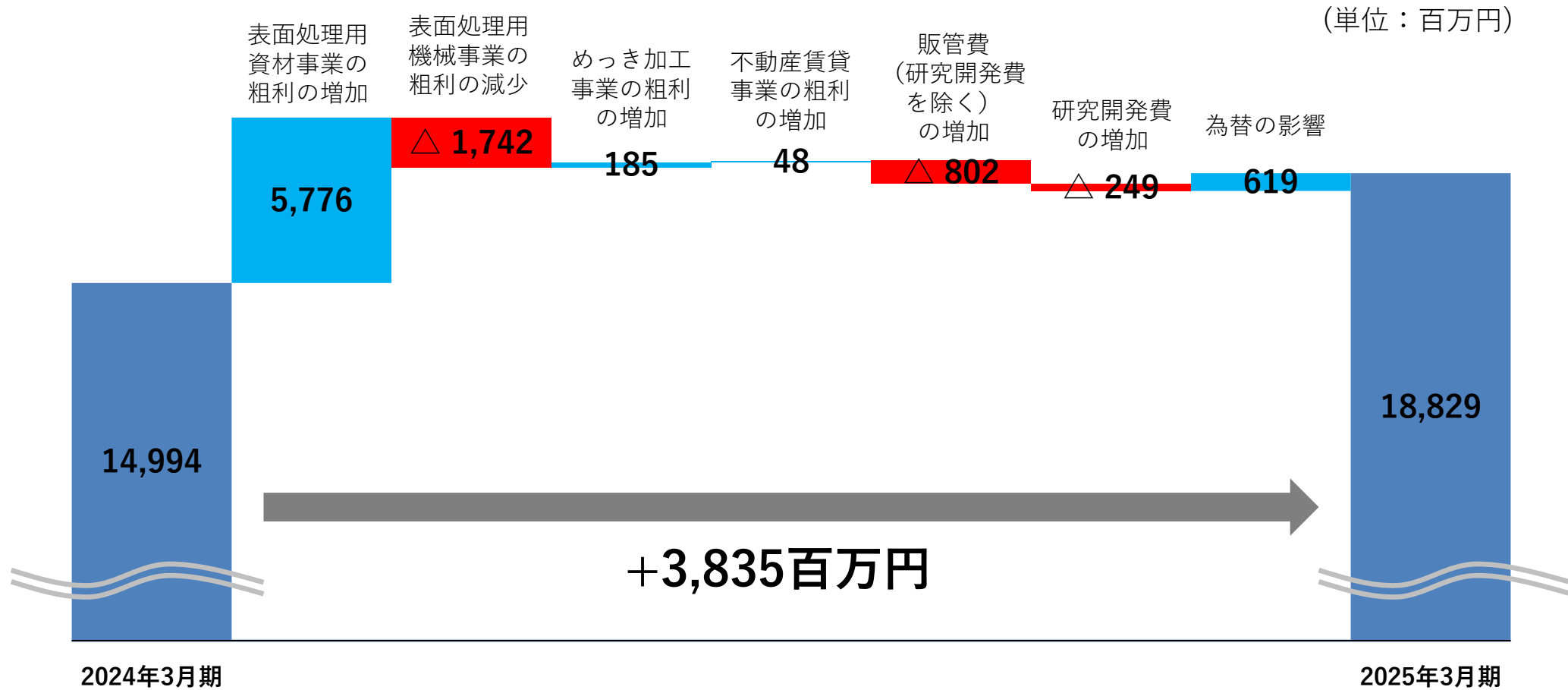


(単位：百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想(2024.11.11修正)	2025年3月期 実績	前期比	予想比
売上高	80,256	81,600	83,845	+ 3,589 (+ 4.5%)	+ 2,245 (+ 2.8%)
営業利益	14,994	18,100	18,829	+ 3,835 (+ 25.6%)	+ 729 (+ 4.0%)
経常利益	15,871	18,800	20,041	+ 4,170 (+ 26.3%)	+ 1,241 (+ 6.6%)
当期純利益	10,920	12,800	14,078	+ 3,158 (+ 28.9%)	+ 1,278 (+ 10.0%)
為替：米ドル	140.67円	151.41円	151.69円	11.02円安	0.28円安

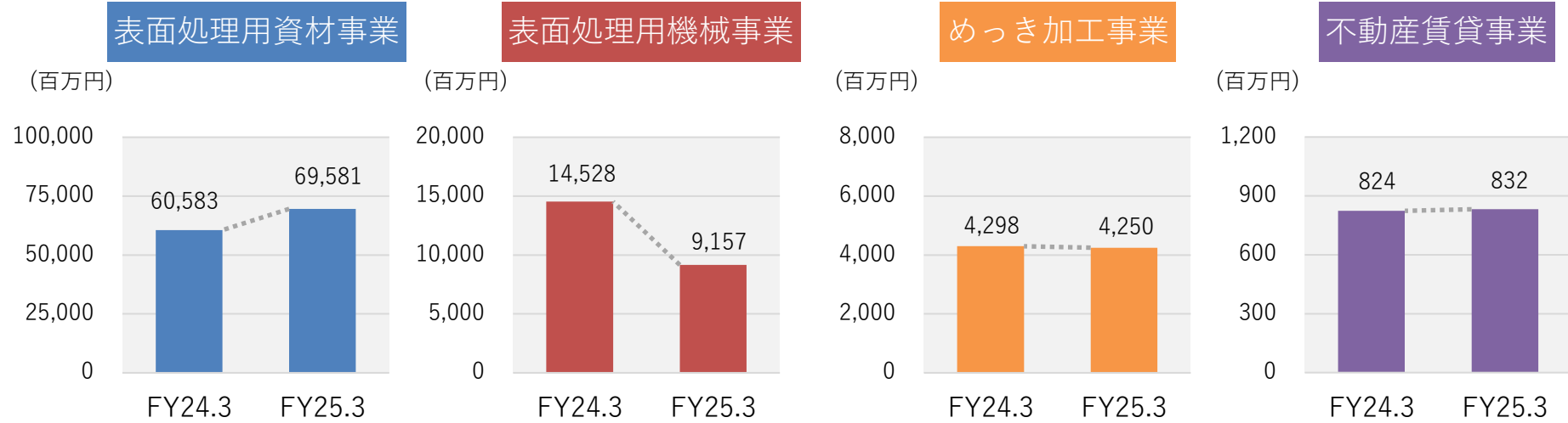
四半期毎の業績推移



営業利益の増減要因



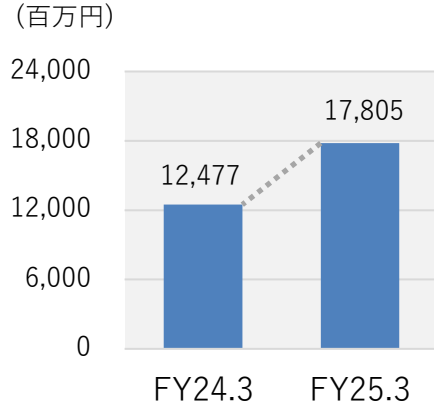
事業セグメント別売上高



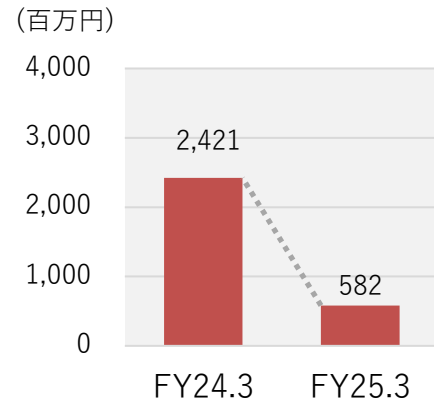
(単位：百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	60,583	69,581	+ 8,998	+ 14.9%
表面処理用機械	14,528	9,157	△ 5,371	△ 37.0%
めっき加工	4,298	4,250	△ 47	△ 1.1%
不動産賃貸	824	832	+ 7	+ 0.9%

事業セグメント別営業利益

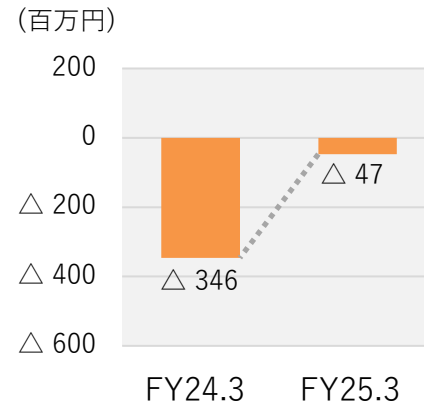
表面処理用資材事業



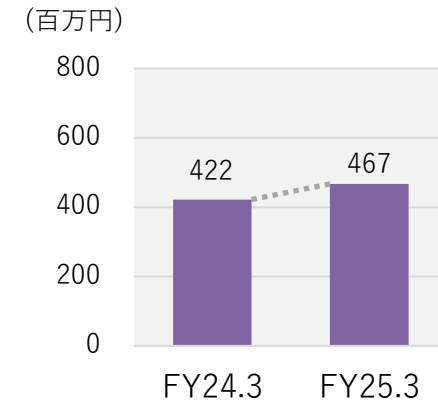
表面処理用機械事業



めっき加工事業

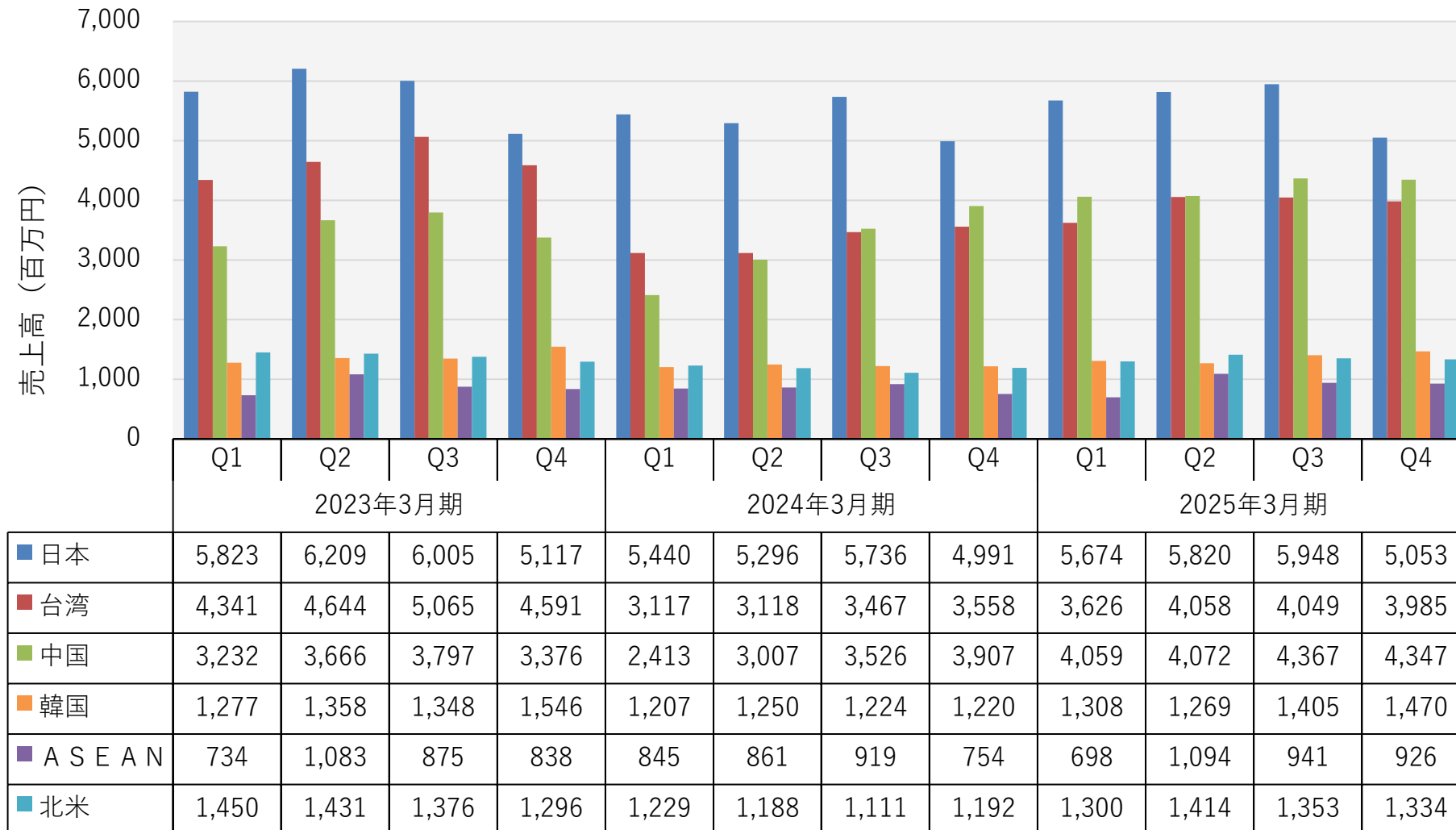


不動産賃貸事業

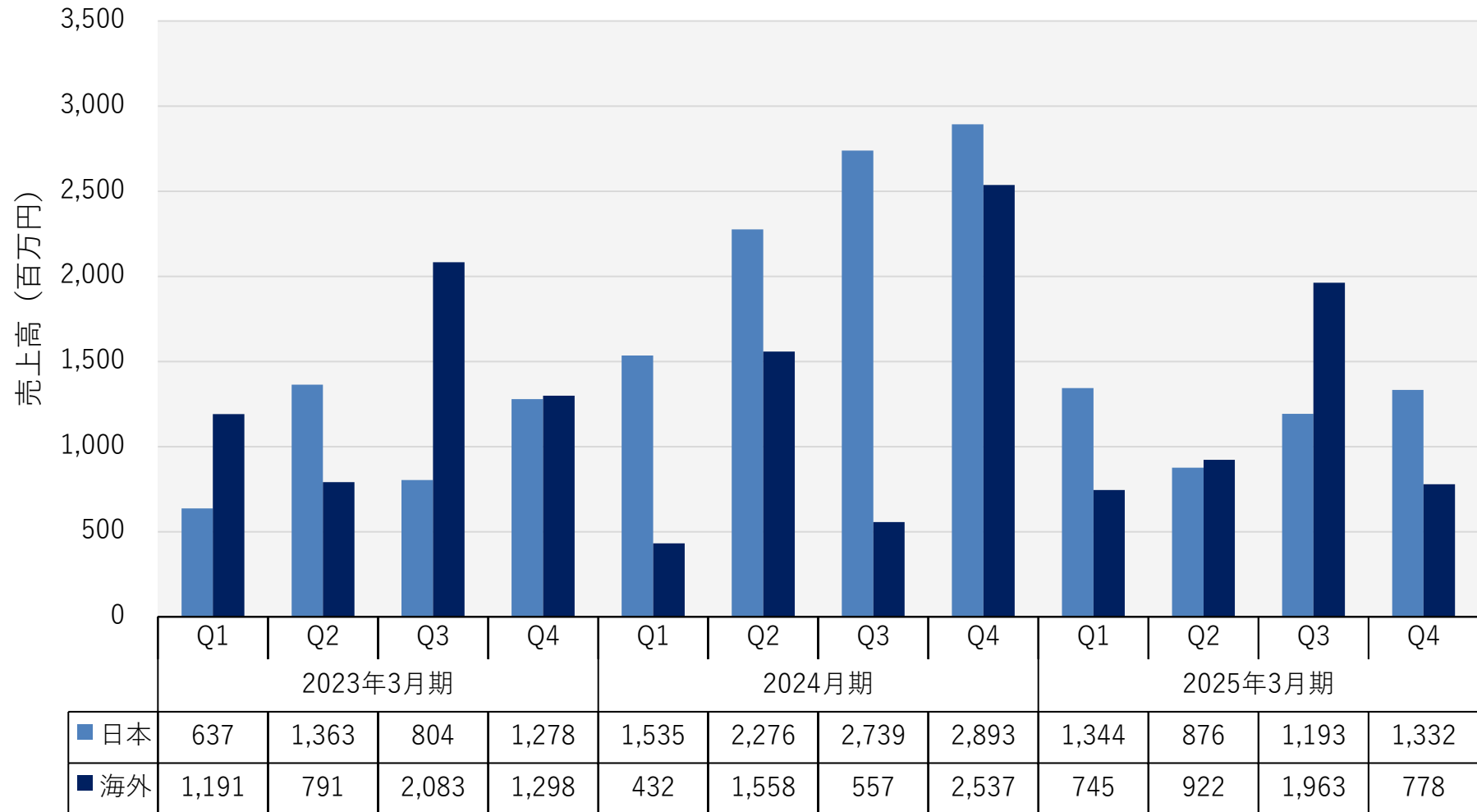


(単位：百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	12,477	17,805	+ 5,327	+ 42.7%
表面処理用機械	2,421	582	△ 1,838	△ 75.9%
めっき加工	△ 346	△ 47	+ 298	-
不動産賃貸	422	467	+ 45	+ 10.7%

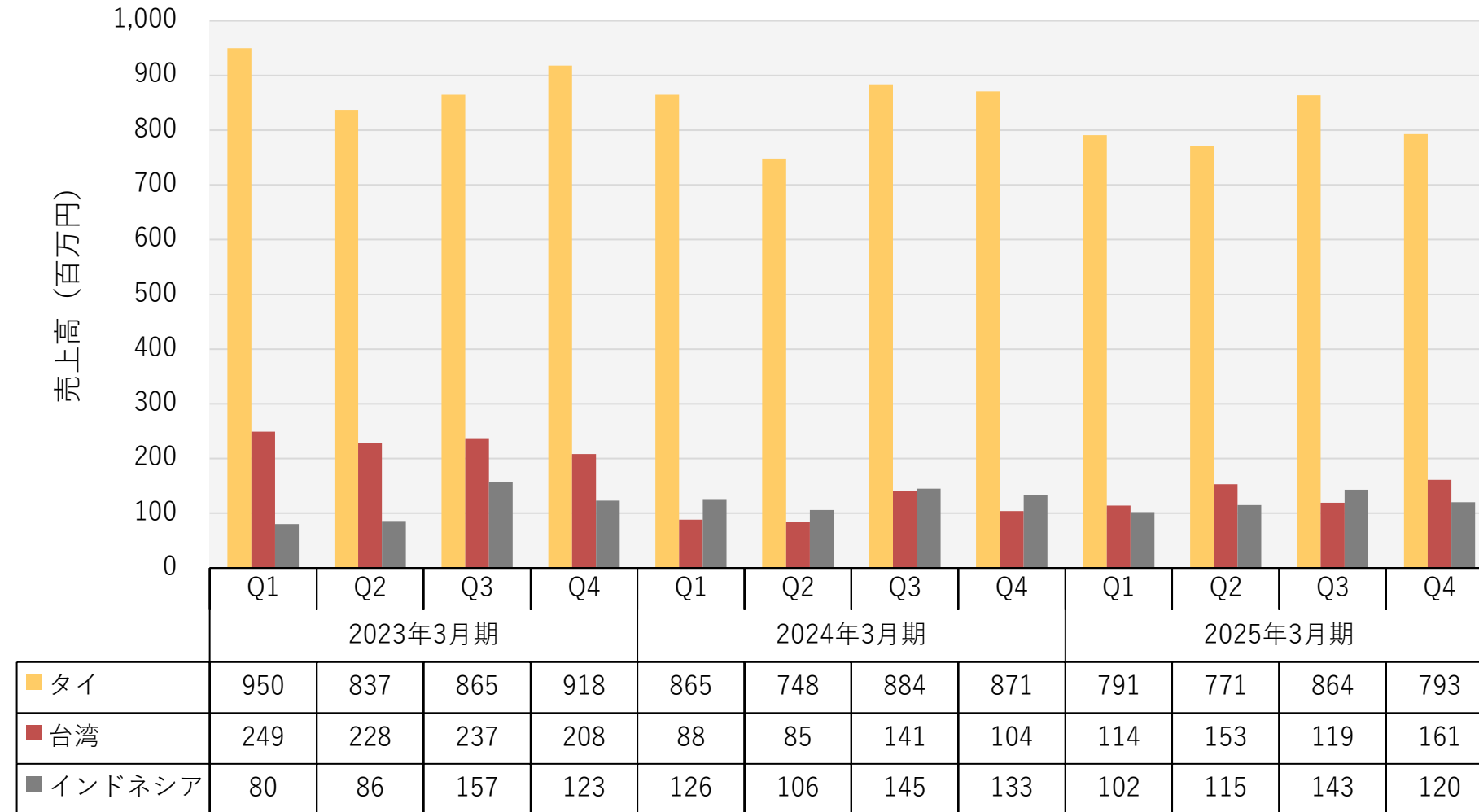
表面处理用資材事業 売上高推移



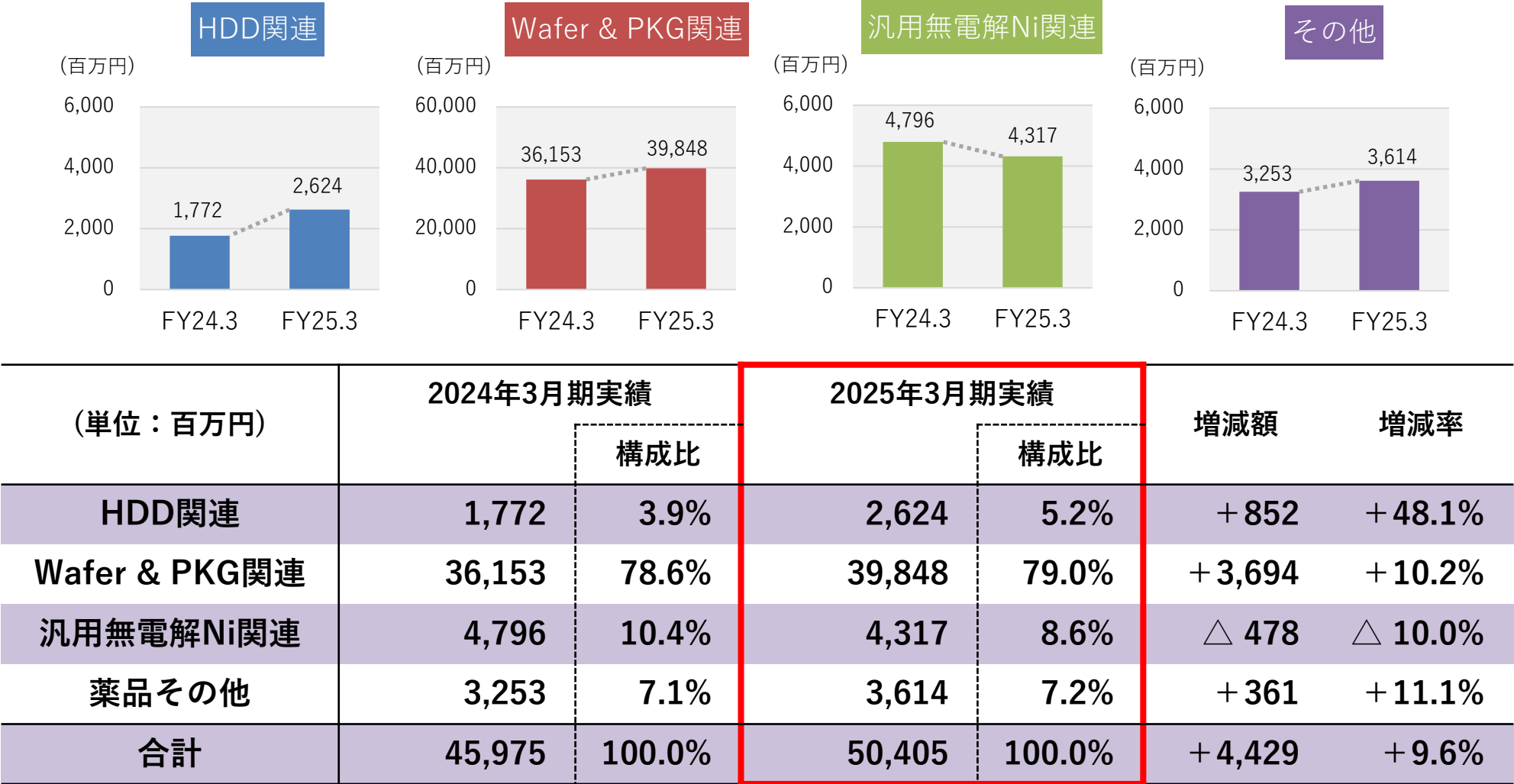
表面処理用機械事業 売上高推移



めっき加工事業 売上高推移

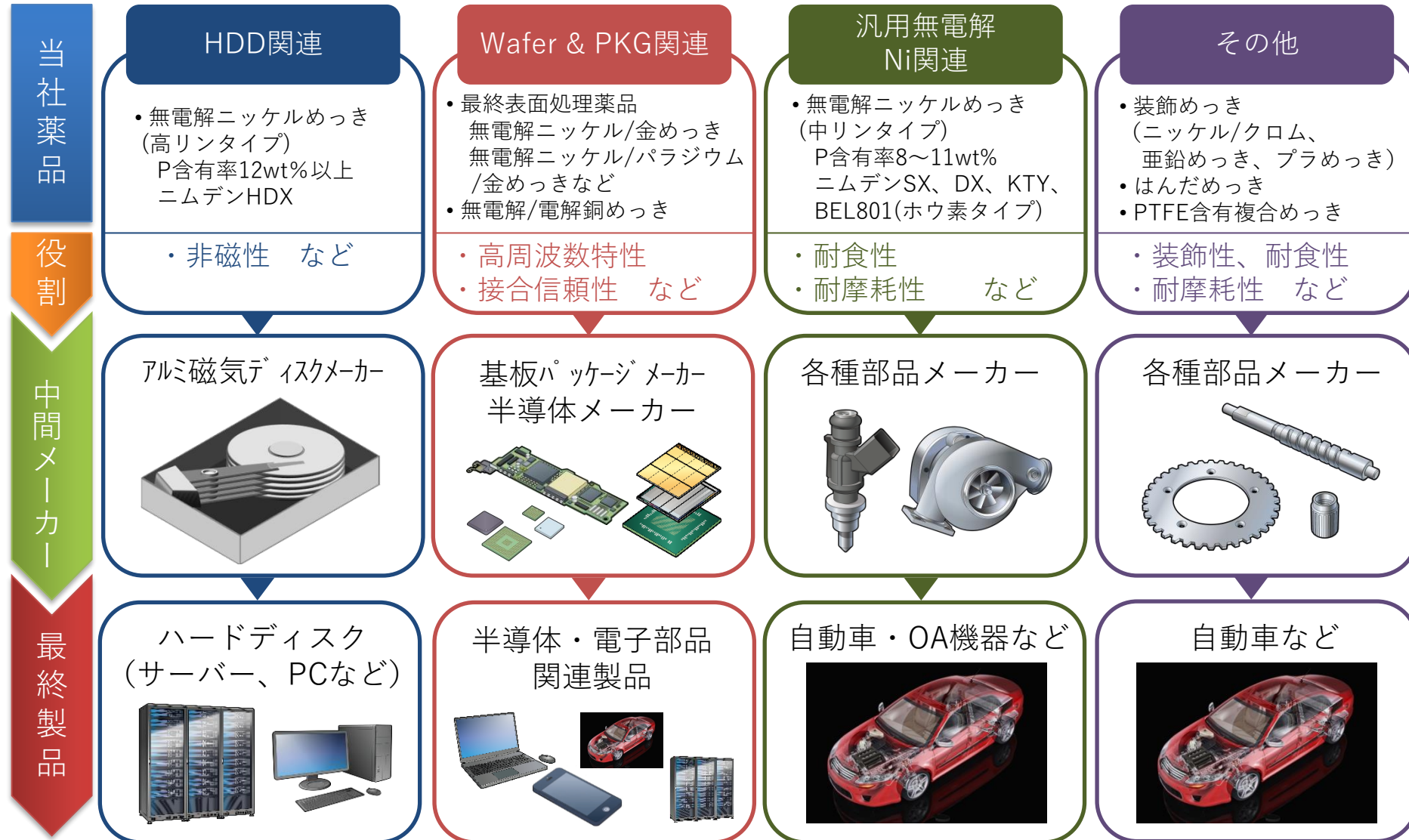


薬品カテゴリー別売上高



薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

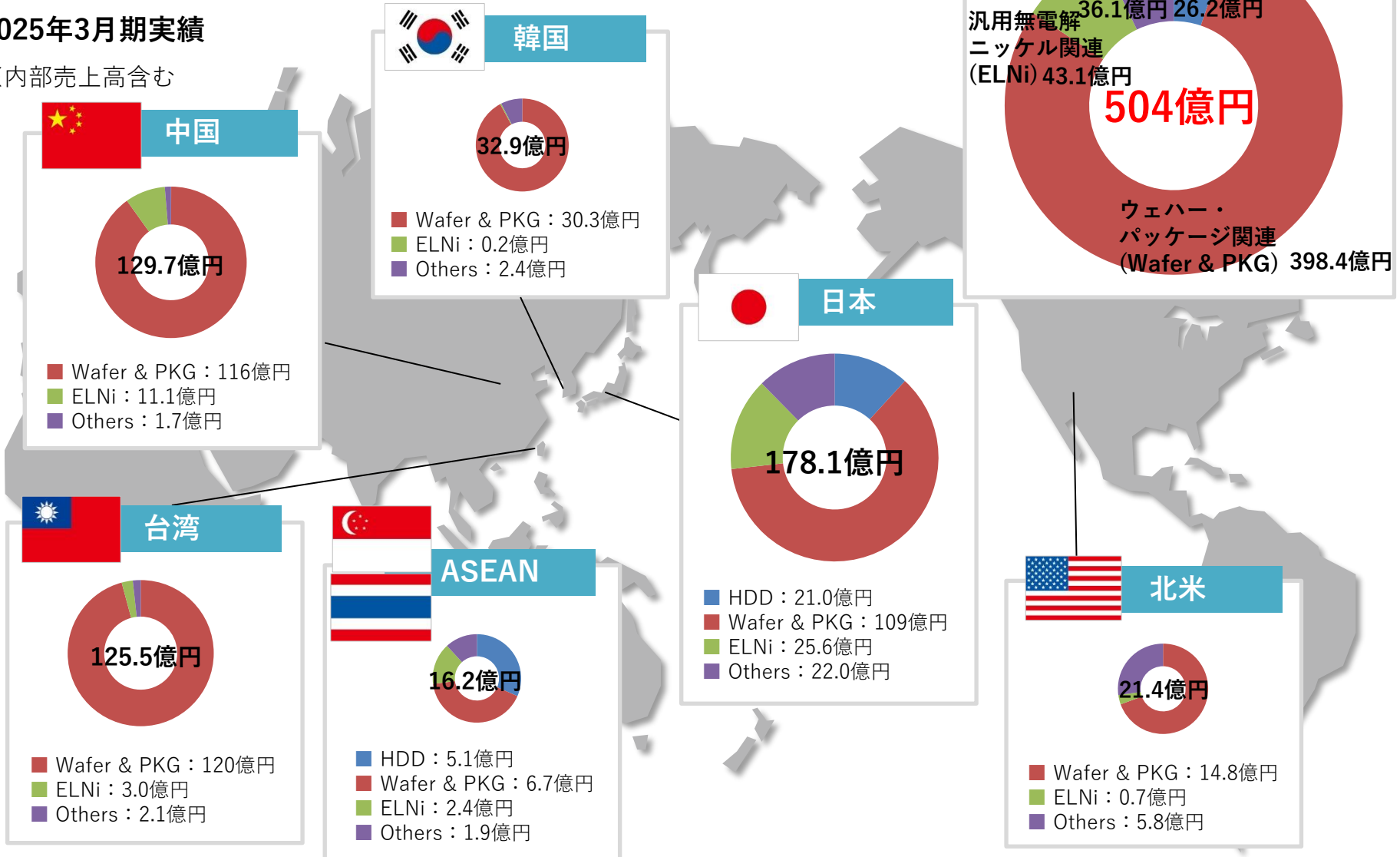
薬品ビジネス 最終製品までの流れ



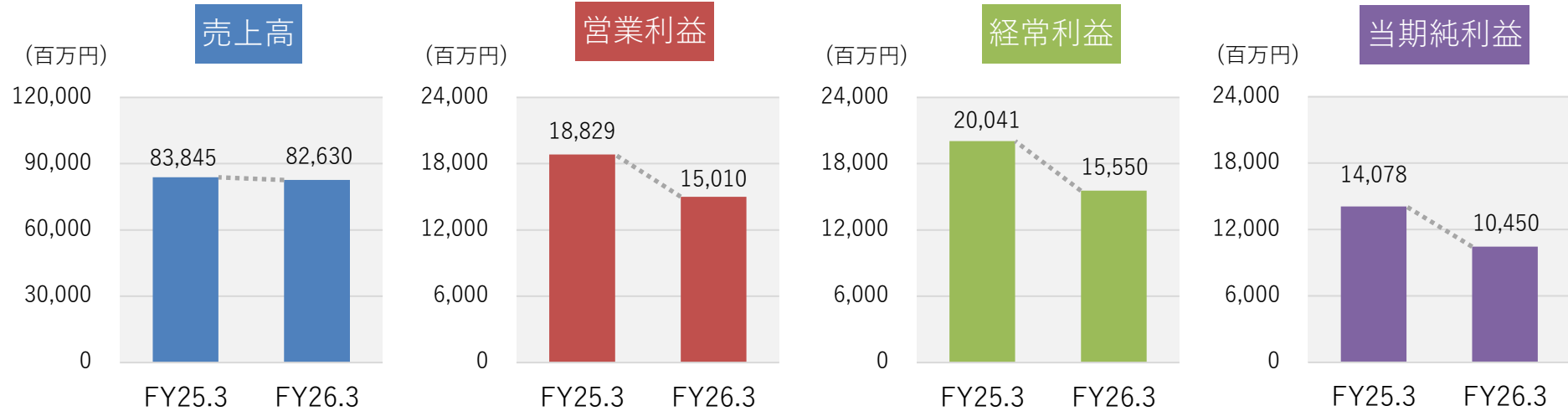
地域別薬品売上高

2025年3月期実績

※内部売上高含む



2026年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	83,845	82,630	△ 1,215	△ 1.4%
営業利益	18,829	15,010	△ 3,819	△ 20.3%
経常利益	20,041	15,550	△ 4,491	△ 22.4%
当期純利益	14,078	10,450	△ 3,628	△ 25.8%
為替：米ドル	151.69円	141.02円	10.67円高	

2026年3月期 通期業績予想

● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率
表面処理用資材	69,581	67,919	△ 1,661	△ 2.4%	17,805	15,137	△ 2,668	△ 15.0%
表面処理用機械	9,157	9,677	+ 520	+ 5.7%	582	382	△ 200	△ 34.4%
めっき加工	4,250	4,190	△ 60	△ 1.4%	△ 47	△ 84	△ 36	-
不動産賃貸	832	820	△ 12	△ 1.5%	467	△ 448	△ 915	-

● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想	増減額	増減率
HDD関連	2,624	2,880	+ 255	+ 9.7%
Wafer & PKG関連	39,848	39,212	△ 636	△ 1.6%
汎用無電解Ni関連	4,317	4,234	△ 83	△ 1.9%
薬品その他	3,614	3,543	△ 71	△ 2.0%
合計	50,405	49,869	△ 536	△ 1.1%

<参考> 為替感応度

2026年3月期想定レート：141.02円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約340百万円増
- ・ 営業利益：約70百万円増

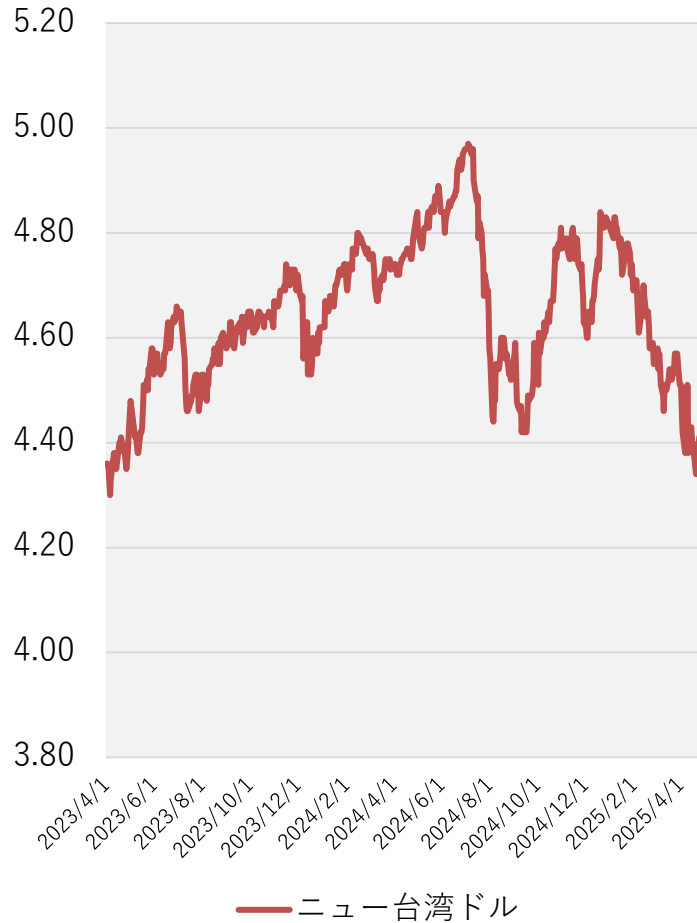
円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約340百万円減
- ・ 営業利益：約70百万円減

※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

為替レートの推移

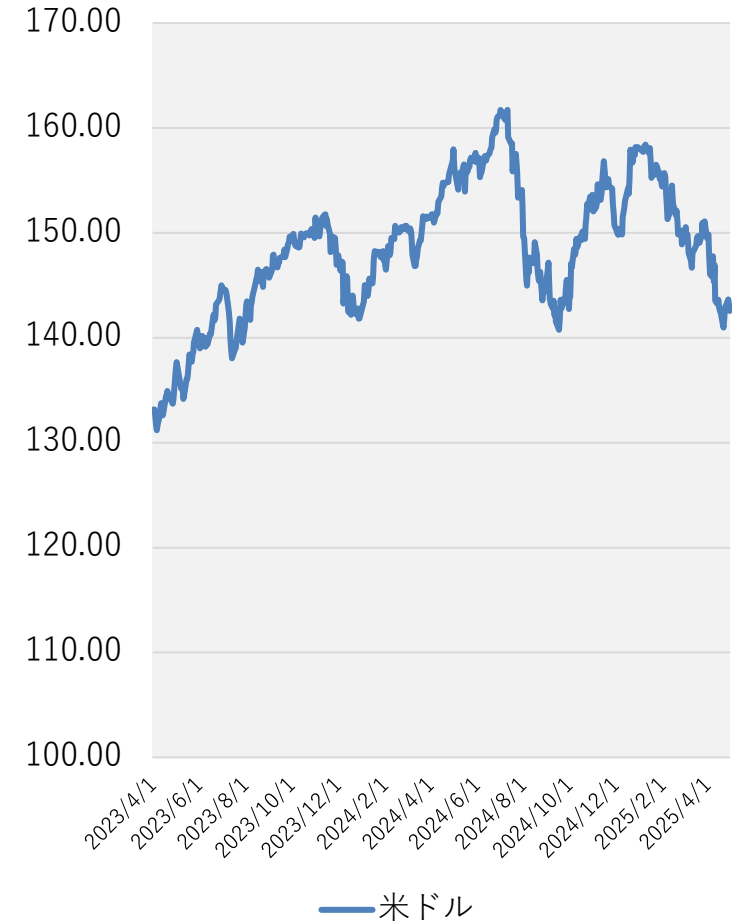
ニュー台湾ドル



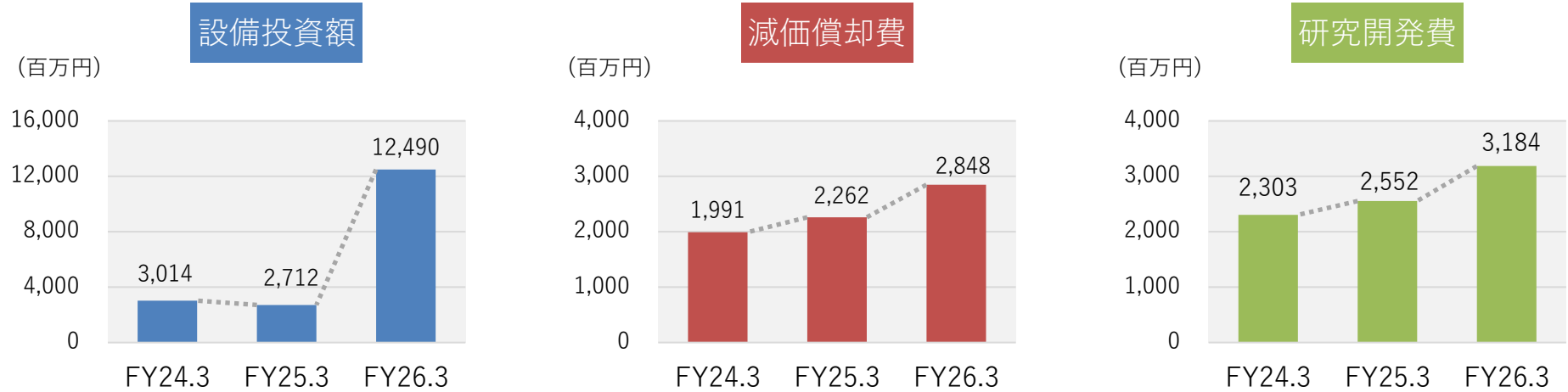
人民元



米ドル



設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	2024年3月期 実績	2025年3月期 実績	2026年3月期 予想
設備投資額	3,014	2,712	12,490
減価償却費	1,991	2,262	2,848
研究開発費	2,303	2,552	3,184

<トピックス> 枚方工場再構築の進捗状況

中央研究所 第3研究棟の新設を計画

枚方工場の再構築の一環として、枚方工場内の管理棟を解体し、中央研究所の新棟（第3研究棟）の建設を計画しております。管理棟の機能は、同工場内の厚生棟へ移転する予定です。第3研究棟の新設により、より一層の研究開発体制の強化と顧客への技術サポート体制の充実を図ってまいります。

中央研究所 第3研究棟の計画概要

- 所在地：大阪府枚方市出口1-5-1（枚方工場敷地内）
- 鉄骨造り、地上3階建（クリーンルーム含む）
- 建築面積：約1,800m²
- 投資予定金額：約20億円（管理棟解体費用含む）
- 完成予定時期：2027年3月

その他の枚方工場再構築の計画

- 化成品工場の増設（2027年12月完成予定）
- 既存化成品工場の再整備
- 製品倉庫の改造

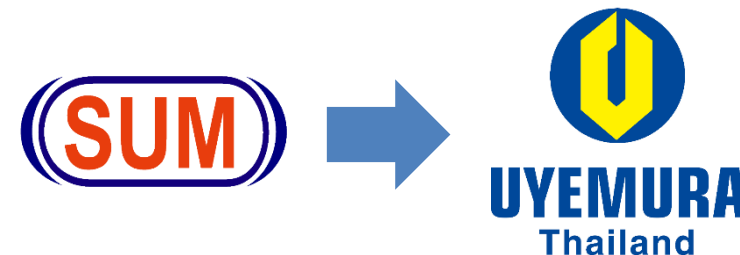


国土地理院撮影の空中写真を加工して作成

<トピックス> タイ子会社の社名変更と技術センター設置

タイ子会社の社名変更

当社のタイ連結子会社であるサムハイテックス（Sum Hitech Co., Ltd.）は、タイ国内での認知度向上と事業拡大を図るため、2025年5月1日付で社名を**ウエムラ・タイランド（Uyemura Thailand Co., Ltd.）**へ変更いたしました。今後はウエムラブランドを前面に打ち出すとともに、めっき薬品のさらなる拡販を目指してまいります。



タイ技術センターの設置

タイ国内における顧客への技術サポートのため、旧めっき加工ラインの跡地に専用の実験室を設け、めっき薬品の拡販に繋げてまいります。

タイ技術センターの計画概要

- 所在地：タイ国パトゥムタニ県ナワナコン工業団地（既存工場敷地内）
- 投資予定金額：約28百万円
- 完成予定時期：2025年6月



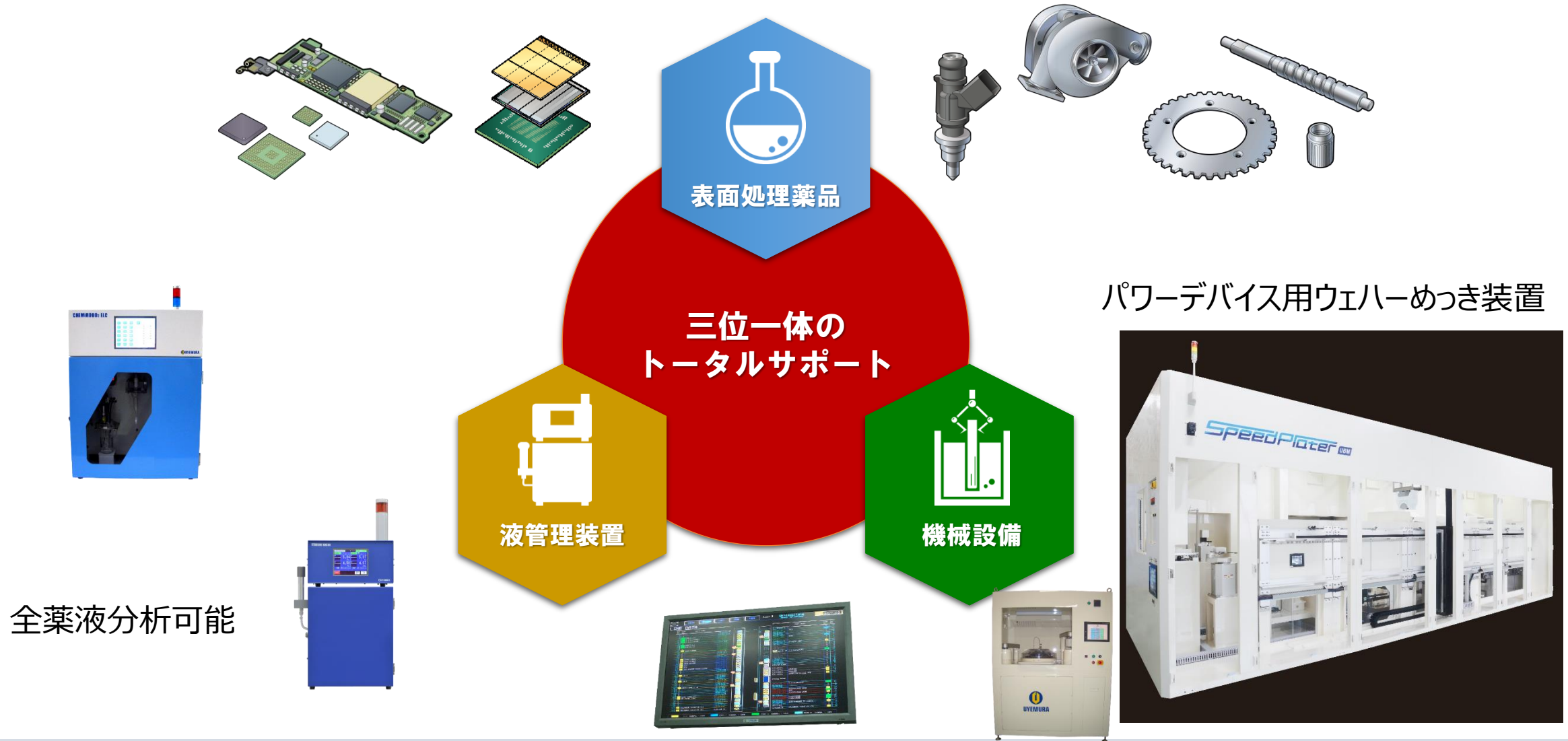
ウエムラ・タイランド
(Uyemura Thailand Co., Ltd.)

主要ビジネス状況

顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供

営業基本戦略



➤ 現行市場状況

① 国内：PC関連、通信、パワーデバイスは緩やかな増加。ハードディスクは好調。

サーバー関連はエンドユーザーのターゲット分野によって差があるが徐々に回復傾向

② 海外：国内とほぼ同じ傾向。

➤ 現在注力している技術

次世代パッケージ技術、通信向け基板技術、カーエレクトロニクス技術、環境関連技術

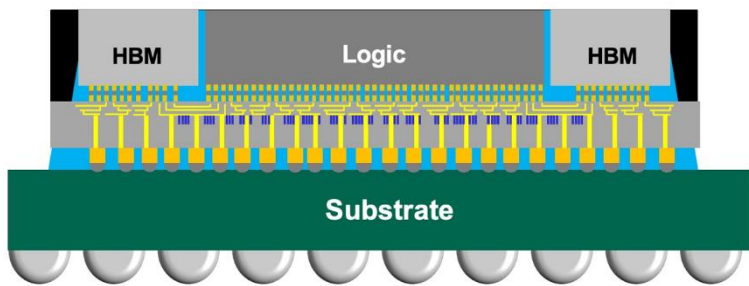
➤ 今後注力すべき技術

先端パッケージ向け配線技術および bumps 接合技術

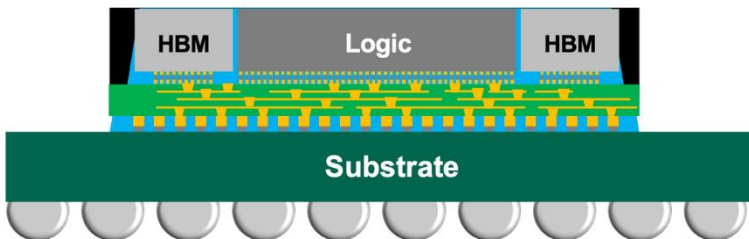
次世代接合材料向け表面処理技術、環境対応トータル技術開発

先端パッケージに求められる技術

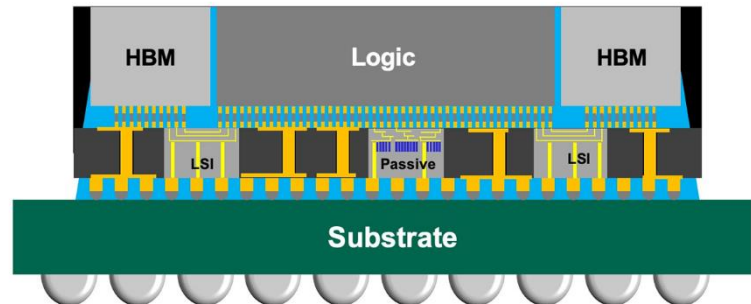
シリコンインターポザー型



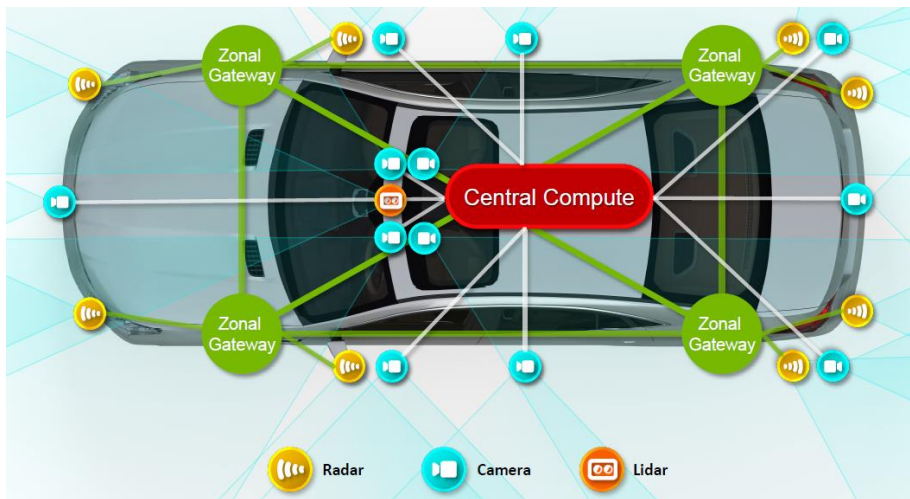
有機インターポザー型



シリコンブリッジ型



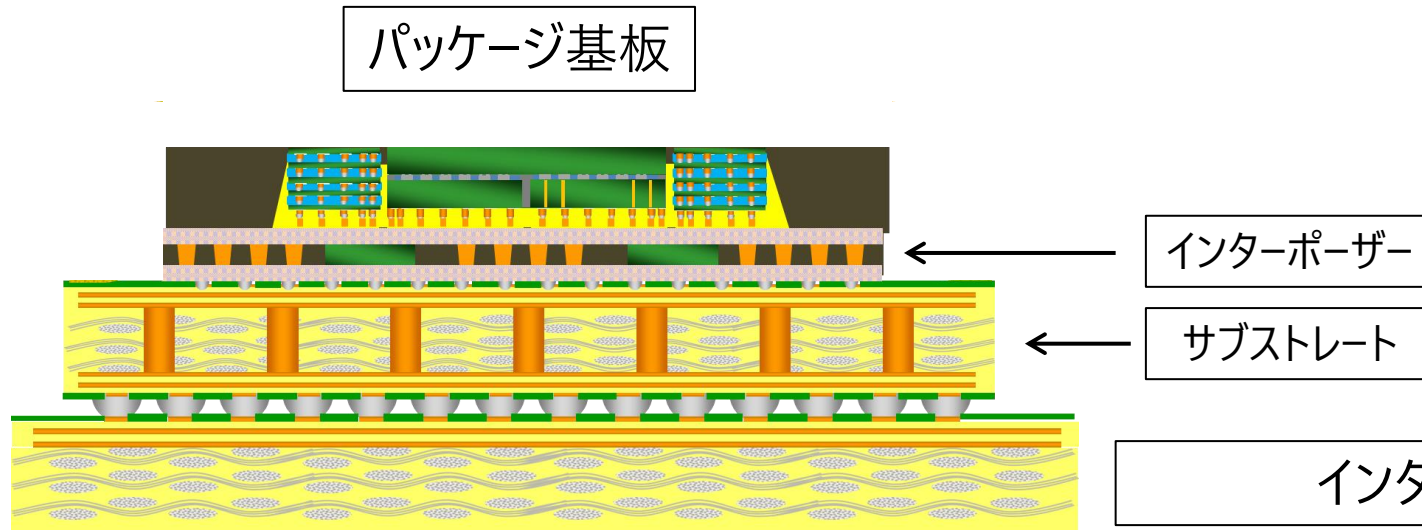
<https://3dfabric.tsmc.com/japanese/dedicatedFoundry/technology/cowos.htm>



- 1) 高信頼性基材への適応
- 2) 高信頼性接合技術の進歩
- 3) 環境対応技術への挑戦

Sailing into the future of the semiconductor industry, TSMC, IEDM2024-technology innovations shaping the roadmap

先端パッケージへのガラスコア適用可能性



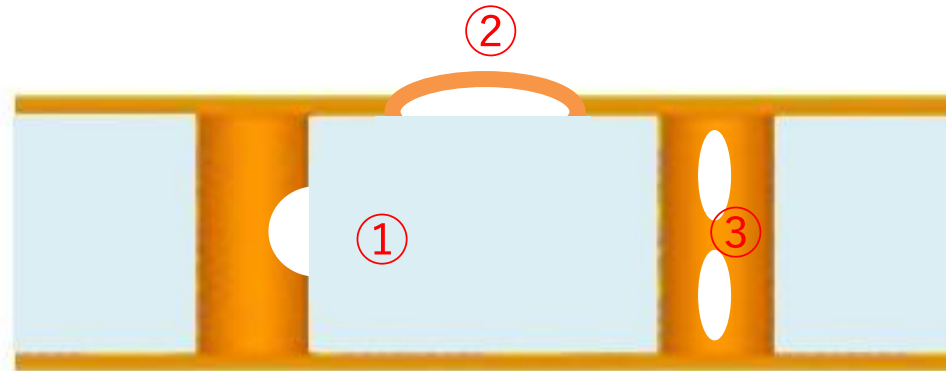
ガラス特性

- 高剛性
- 低熱膨張係数
- 高平滑性

要求特性

- ⇒ ねじれ寸法精度
- ⇒ 反り寸法精度
- ⇒ 微細配線形成

インターポザーやサブストレートにガラス採用



スルホール付きガラス基板

懸念事項

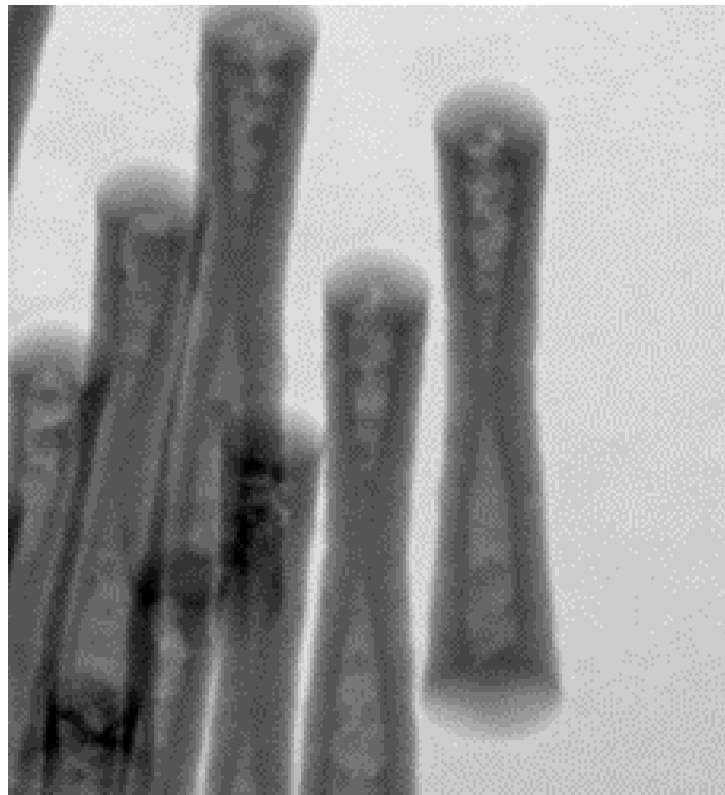
- ① スルホール内断線
- ② 配線密着性
- ③ TH内部の埋め込み性

ガラスコア向けシード層及びTH filling電解Cuの提案

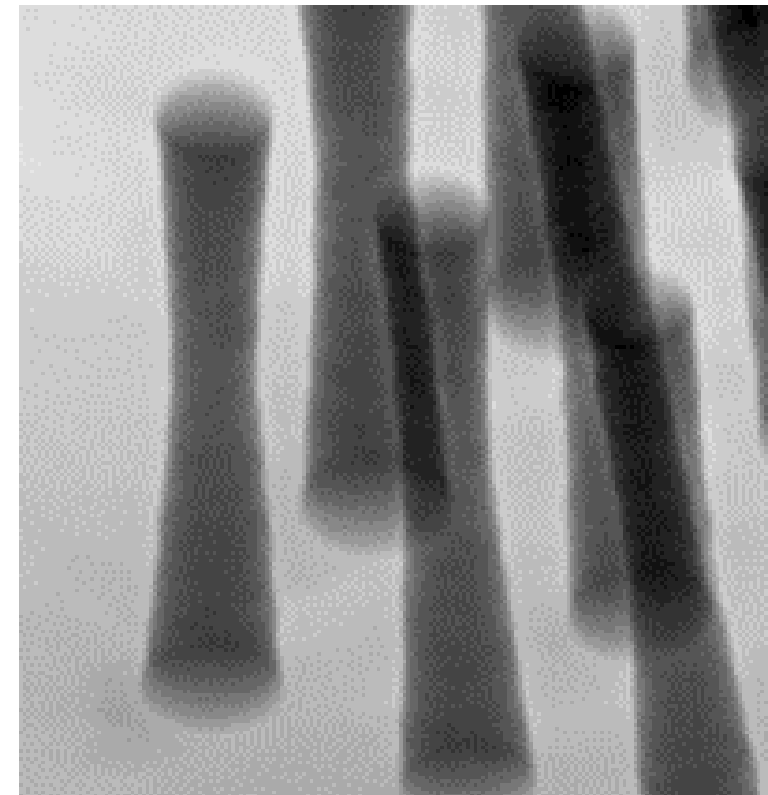
MOSL
(Metal Oxide Seed Layer)

Electroless Cu
(Seed for Electrolytic Cu)

Electrolytic Cu
(TH Filling)



Old electrolytic Cu

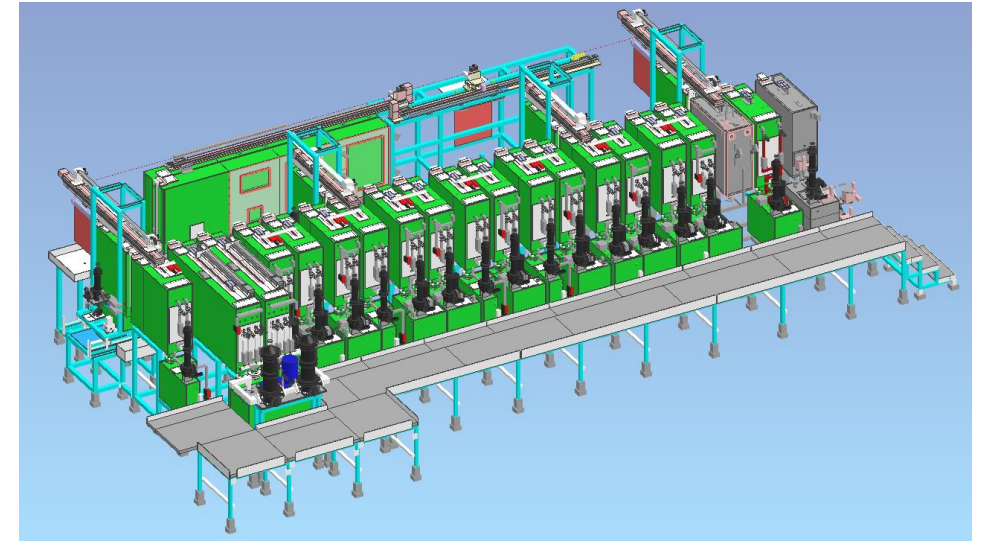
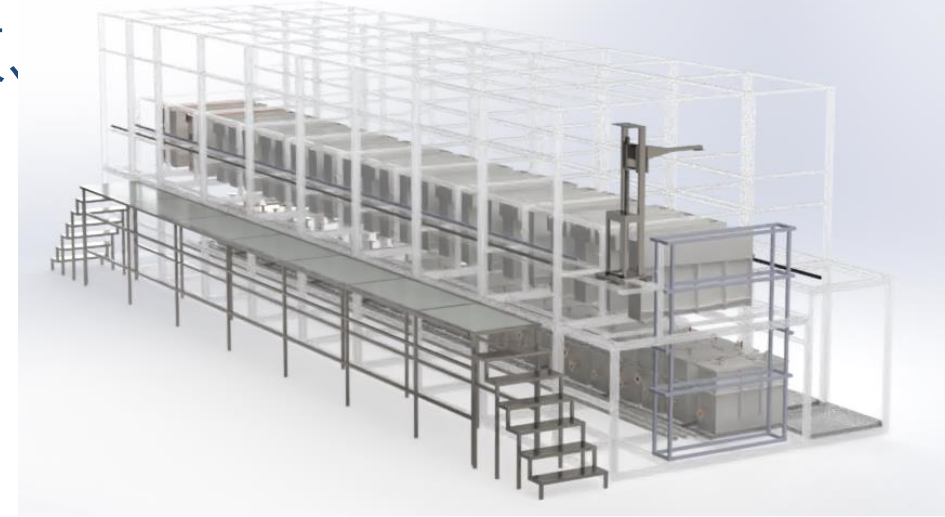
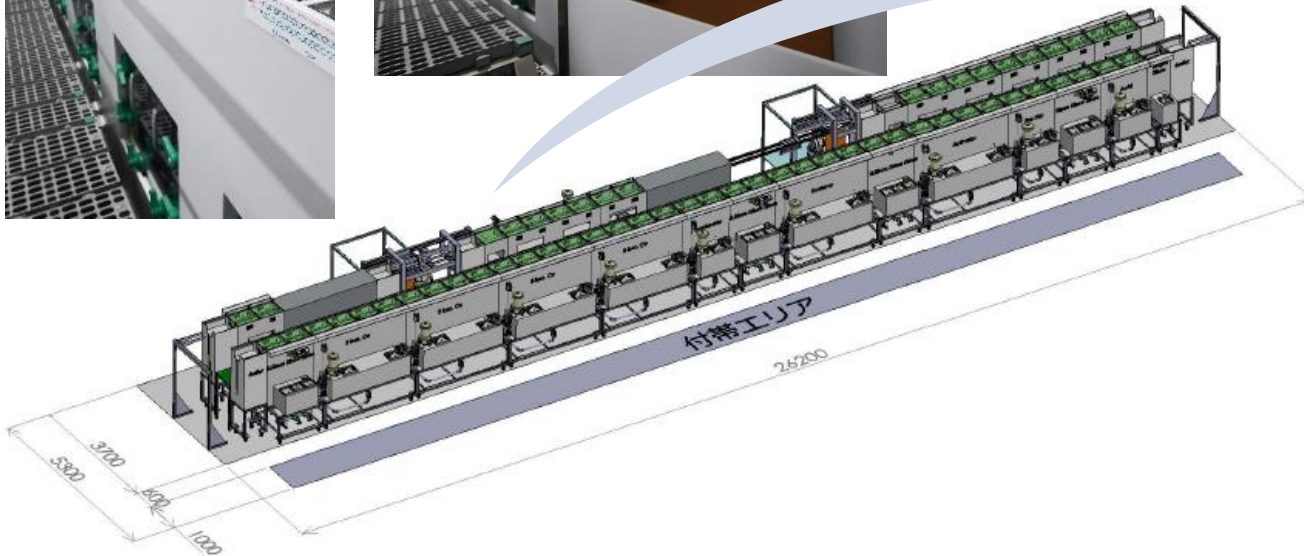


New electrolytic Cu

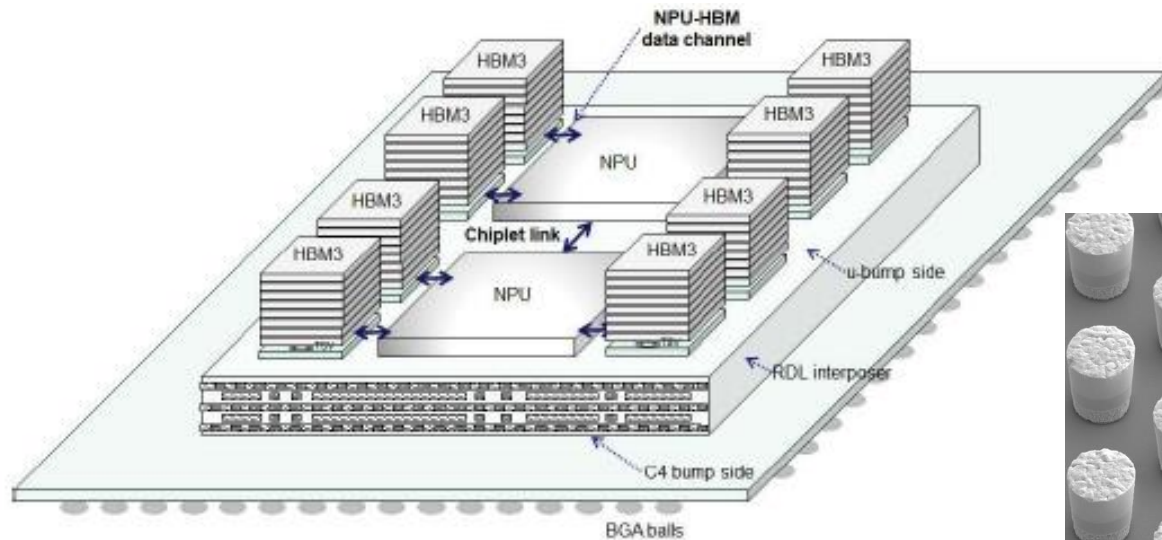
TGV opening diameter	100 μm
TGV center diameter	70 μm
Board thickness	600 μm

U-VCPS(Vertical Continuous Plating System)の進化

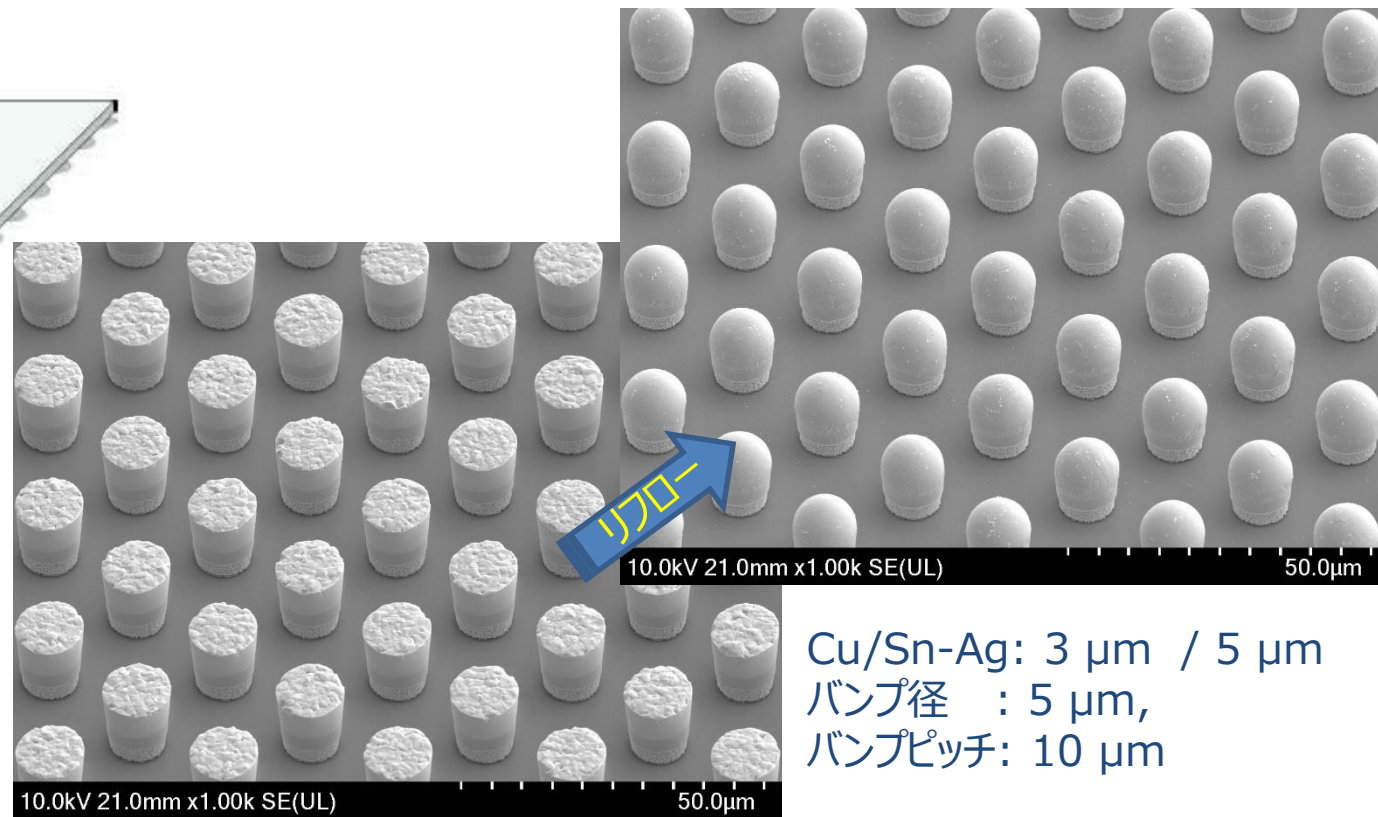
コアレスを含めた50 μ m未満の薄板有機基板、
ガラス基板への適用可能性



先進パッケージ向けバンプ形成技術の提案



Chiplet Heterogeneous-Integration AI Processor,
International conference on Electronics, Information
and Communication (ICEIC), February 2023

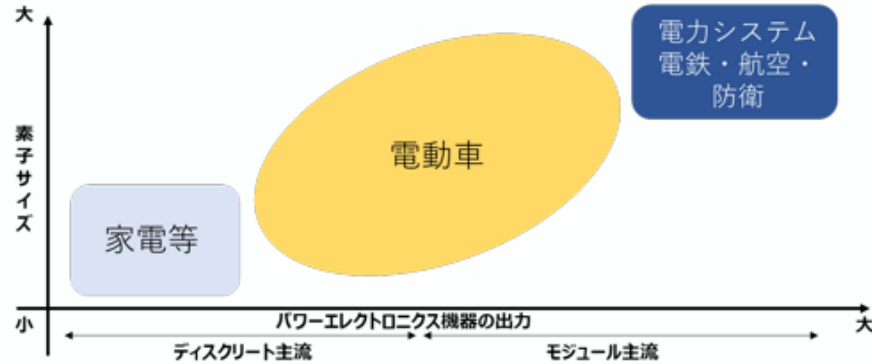


Cu/Sn-Ag: 3 μm / 5 μm
バンプ径 : 5 μm ,
バンプピッチ: 10 μm

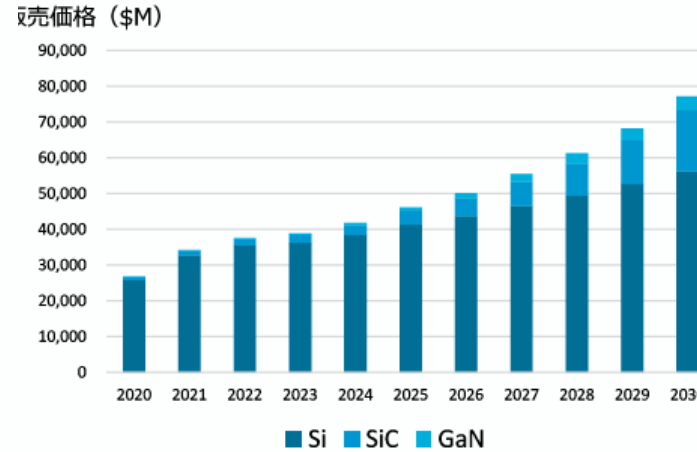
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
「ポスト 5 G 情報通信システム基盤強化研究 開発事業」(JPNP20017)

次世代パワー半導体に求められる技術

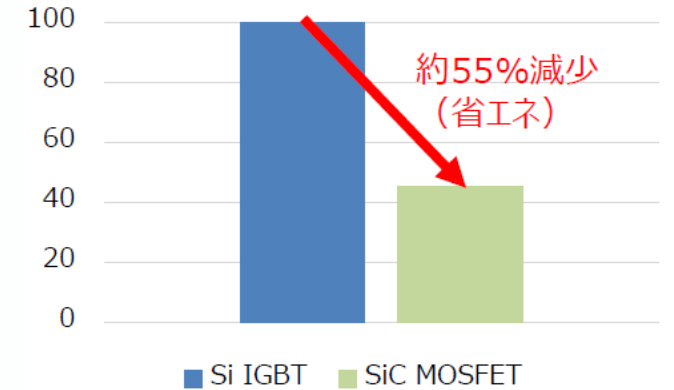
＜パワー半導体の特性と用途＞



＜パワー半導体の需要動向予測＞



＜Si/SiCパワー半導体のエネルギー損失＞



※用途は、鉄道車両用インバーターを想定
※縦軸（エネルギー損失）は、Siパワー半導体を100とした場合の値

半導体・デジタル産業戦略の現状と今後, 経済産業省, 令和6年12月23日

＜ SiCの特性 ＞

- 1) 電力損失の低減
- 2) 高い動作温度
- 3) 高速スイッチング動作
- 4) 高い放熱効果

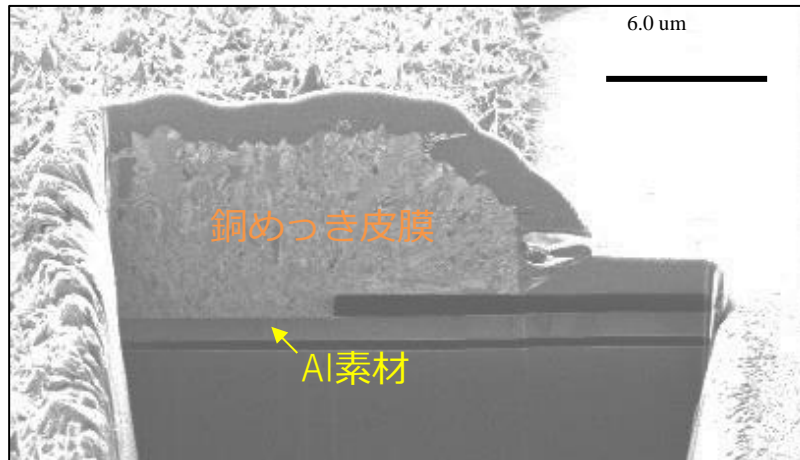
高い動作温度へ適応した材料

→ 焼結材料、封止材料、表面処理、等

新規接合材料（銀焼結、銅焼結、銅ワイヤ）へ適したプロセスの提案

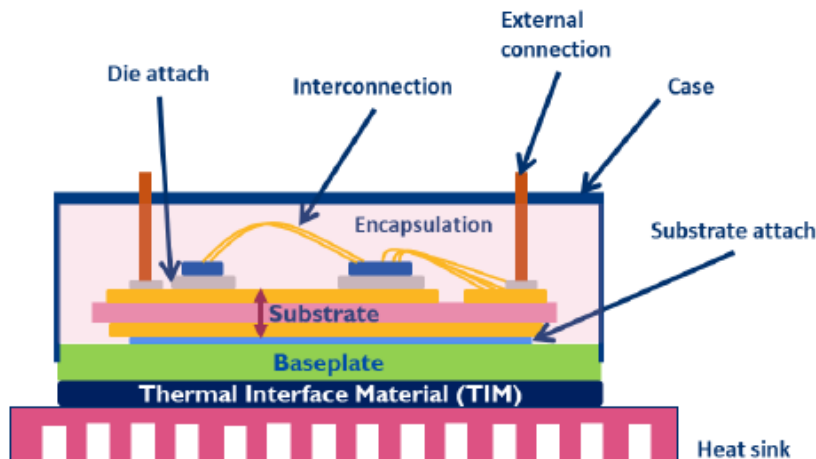
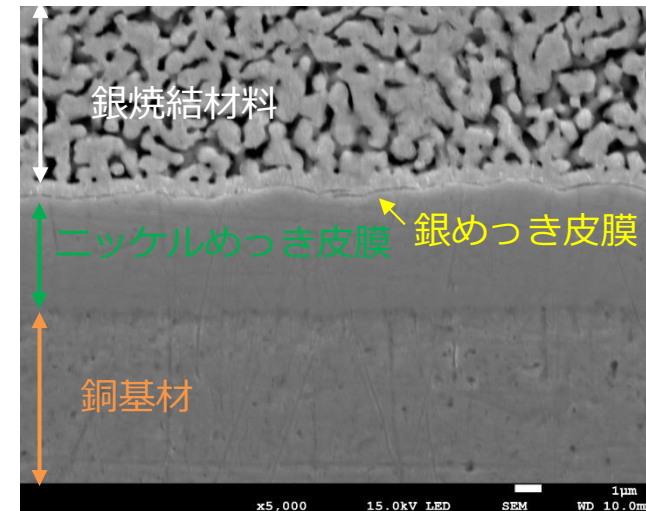
耐熱クラック性に優れた
Ni-P皮膜形成

After TCT(-50℃⇔250℃)



銅焼結、銅ワイヤとの接合性に優れた
Al上ダイレクト無電解Cu

「銀」焼結材料への接合性
に優れた「銀」皮膜形成



Status of the Power Module Packaging
Industry 2021-Market and Technology
Report, Yole development, November 2021

ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (UY:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています

Environment（環境）

環境対応型製品・技術の開発・拡販



社会発展・環境改善へとつながる製品の開発・提供



廃棄物・水使用量の削減



クリーンエネルギーの使用、電力使用量の削減



持続可能な
社会の実現

Social（社会）

社会貢献・地域貢献活動の推進



受注から出荷までの工程の自動化

いきいきと働ける職場環境の整備



Governance（ガバナンス）

コンプライアンスの徹底、人権の尊重



BCP（事業継続計画）の実施



詳細な取り組み内容については、当社ホームページをご確認ください



1. Pbフリーめっき浴

- ・無電解Niめっき浴。主に汎用浴向け。
- ・Pbフリーの電気Snめっき浴。純Sn、Sn-Ag浴など。電子部品向け。

2. シアンフリー浴

- ・シアンフリー & フリーシアン補給不要の無電解Auめっき浴。ウェハー、電子部品向け。

3. デスミアフリープロセス

- ・危険な過マンガン酸をつかわない基板向けプロセス。

4. ホルマリンフリー浴およびホルマリン不使用プロセス

- ・ホルマリンフリー無電解Cu浴の開発。ウェハー向け。

5. PFOS, PFOA, PFASフリー浴

- ・PTFE複合めっき。主に車載部品向け。

6. 廃液処理

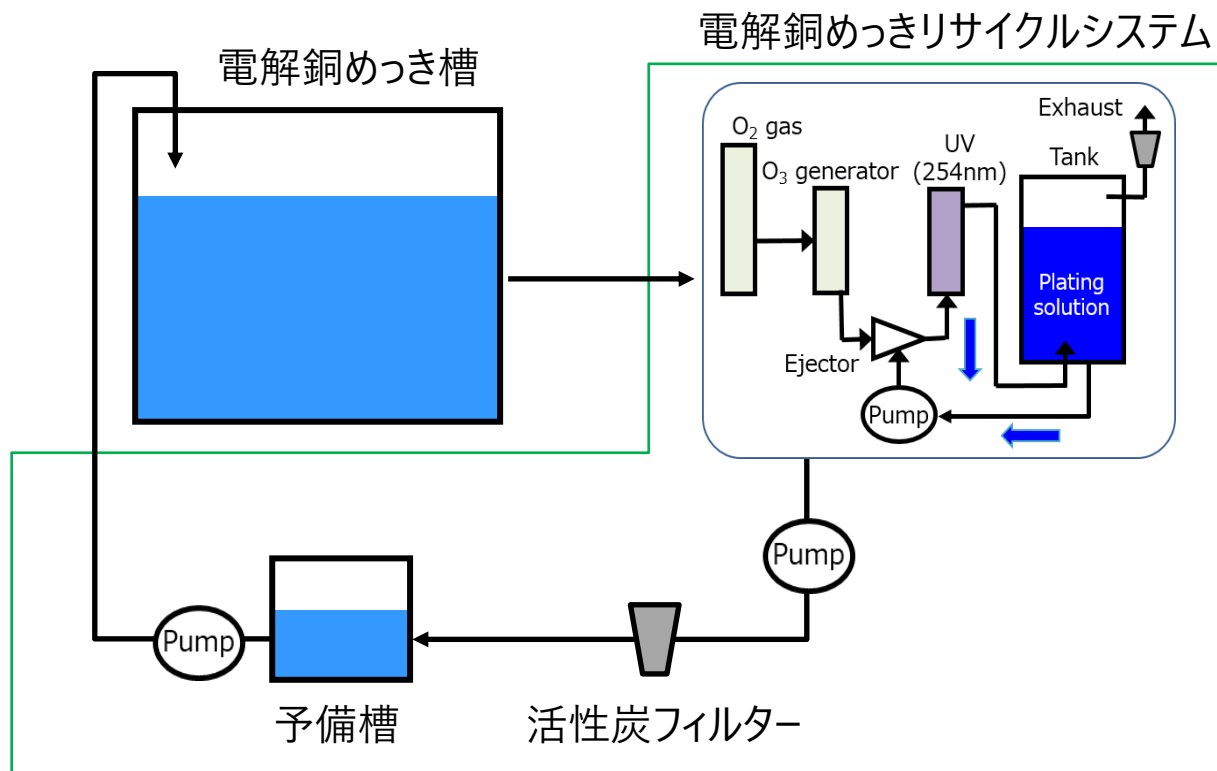
- ・めっき液リサイクルユニット

7. CO₂削減

- ・低融点接合材料めっき、低融点接合に適した最終表面処理



電解銅めっき リサイクルシステムイメージ



< 従来 >

電解銅めっき液は老廃物蓄積に伴い、一定期間使用後に全量廃液

< 新規提案 >

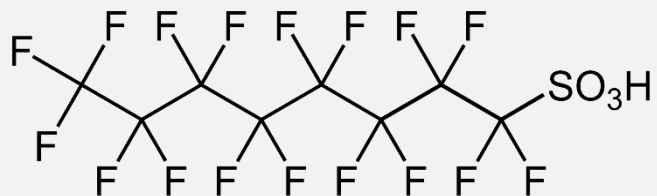
めっき液の一部を再生システムによって老廃物を分解除去することで、めっき液全体の性能を一定に保持

→半永久的なめっき液寿命

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals)

PFAS : Per- and PolyFluoroAlkyl Substances

PFOS : perfluorooctanesulfonic acid



2019~ PFOA free type

NIMUFLON, NIMUFLON FUL (Type JB)

2011~ PFOS free type

NIMUFLON, NIMUFLON FUL (Type B)

PFOA : perfluorooctanoic acid



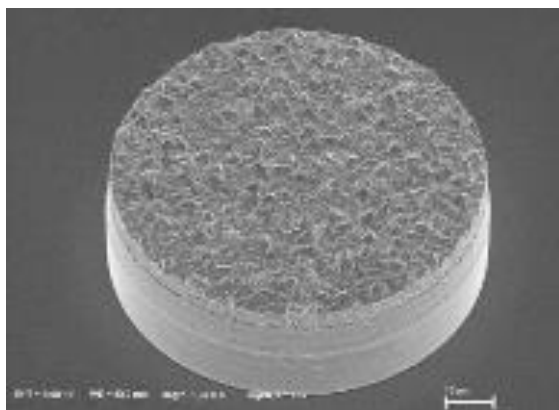
2024~ PFAS free type

NIMUFLON FUL (FPR-1)
(Development completed)

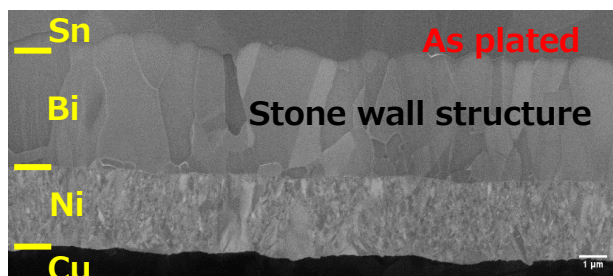
様々なPTFE共析量へ
対応した開発を継続中

低融点 → 省電力 → CO₂削減

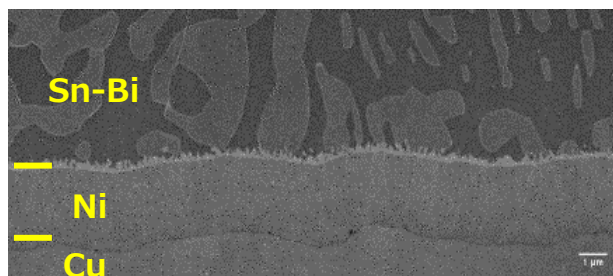
1) 低融点はんだ材料のバンプめっき



Sn surface
(Cu/Ni/Bi/Sn)

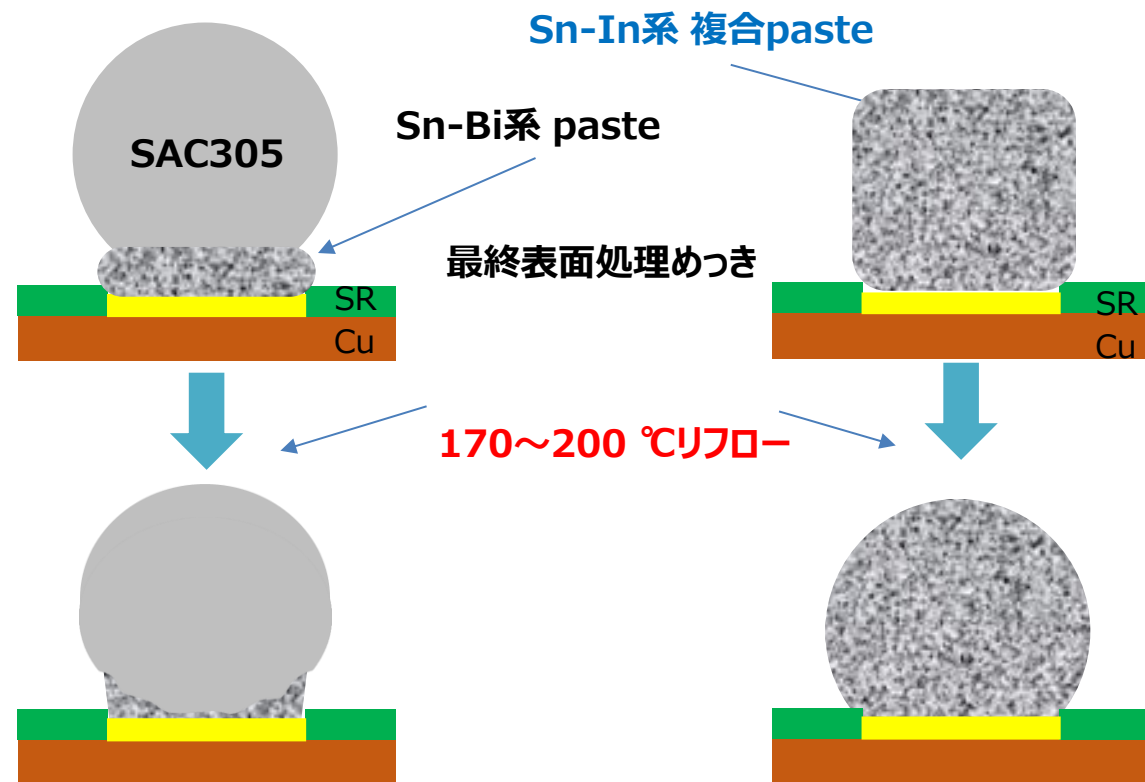


150 °Cリフロー

































Solder/solder joint for low temperature reflow by multi plating method, Wafer-level Packaging Symposium, January 2023

2) 低融点はんだ材料に適した最終表面処理の検討



グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
ウエムラ・タイランド	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

Growing together with



Uyemura Group Companies

● Japan	C.Uyemura & Co., Ltd.	● Taiwan	Taiwan Uyemura Co., Ltd.
● USA	Uyemura International Corporation	● Korea	Uyemura Korea Co., Ltd.
● Hong Kong	Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd.	● Singapore	Uyemura International (Singapore) Pte Ltd
● Shenzhen	Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd.	● Malaysia	Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd.
● Shanghai	Uyemura (Shanghai) Co., Ltd.	● Thailand	Uyemura Thailand Co., Ltd.
		● Indonesia	PT. Uyemura Indonesia